



2027年3月期 第1四半期決算短信（日本基準）（連結）

2026年7月30日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長

(氏名) 前野 俊輔

TEL 03-5561-7000

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2027年3月期第1四半期の連結業績（2026年4月1日～2026年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期第1四半期	732,388	33.3	211,407	46.1	215,626	46.3	164,341	39.5
2026年3月期第1四半期	549,586	△1.0	144,694	△12.7	147,347	△12.0	117,801	△6.6

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 249,188百万円 (48.5%) 2026年3月期第1四半期 167,791百万円 (△16.7%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期第1四半期	361.36	360.15
2026年3月期第1四半期	257.13	256.49

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年3月期第1四半期	2,955,405	2,142,901	71.7
2026年3月期	2,860,997	2,069,996	71.5

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 2,118,056百万円 2026年3月期 2,046,298百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	264.00	—	364.00	628.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期 (予想)	—	384.00	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

配当予想の修正につきましては、[添付資料] 4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。なお、2027年3月期(予想)の期末配当額については現時点では未定であり、第2四半期(中間期)の決算発表時に通期連結業績予想と併せて開示する予定であります。

3. 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想（2026年4月1日～2026年9月30日）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
第2四半期(累計)	1,620,000	37.3	458,000	51.1	464,000	51.2	349,000	44.4
								767.51

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

業績予想の修正につきましては、[添付資料] 4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。なお、通期連結業績予想は、第2四半期(中間期)の決算発表時に開示する予定であります。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、[添付資料] 9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2027年3月期1Q	468,032,733 株	2026年3月期	471,632,733 株
② 期末自己株式数	2027年3月期1Q	13,381,537 株	2026年3月期	16,783,041 株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	2027年3月期1Q	454,785,263 株	2026年3月期1Q	458,132,543 株

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2027年3月期1Q 1,308,766株、2026年3月期 1,308,766株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、[添付資料] 4ページ「1. 経営成績等の概況 (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2026年7月30日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、同日中に当社ホームページに掲載する予定です。 <https://www.tel.co.jp/ir/library/report/>

【添付資料】

[目次]

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 当四半期のキャッシュ・フローの概況	2
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9
(セグメント情報等の注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間の世界経済につきましては、中東の地政学的緊張の高まりに伴うエネルギー価格の上昇などを背景に、欧米諸国ではインフレが加速しており、今後のマクロ経済動向を注視する必要があるものの、景気は総じて底堅く推移しました。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、データセンター向けAIサーバーの需要拡大が半導体市場全体の成長を牽引しました。

このような状況のもと半導体製造装置市場は、前年同期と比べ、AI用途の半導体向け設備投資が顕著に伸長しました。

情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、そして脱炭素社会の実現に向けた取り組みを背景に、半導体の役割とその技術革新の重要性が高まるとともに、半導体製造装置市場も中長期的にさらなる成長が期待されております。

この結果、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高7,323億8千8百万円(前年同期比33.3%増)、営業利益2,114億7百万円(前年同期比46.1%増)、経常利益2,156億2千6百万円(前年同期比46.3%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,643億4千1百万円(前年同期比39.5%増)となりました。

なお、当社グループは「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ324億4千6百万円減少し、1兆8,030億2千万円となりました。主として、有価証券の減少549億9千8百万円、現金及び預金の減少416億4千4百万円、棚卸資産の増加384億3千4百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加181億6千8百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から210億3千2百万円増加し、6,103億6千7百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から11億8千9百万円増加し、387億2千万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から1,046億3千2百万円増加し、5,032億9千6百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から944億7百万円増加し、2兆9,554億5百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ56億3千2百万円増加し、6,848億7千4百万円となりました。主として、前受金の増加238億3千4百万円、支払手形及び買掛金の増加160億5千8百万円、未払法人税等の減少451億3千万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ158億7千万円増加し、1,276億2千9百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ729億5百万円増加し、2兆1,429億1百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,643億4千1百万円を計上したことによる増加、その他有価証券評価差額金の増加806億1千8百万円、前期の期末配当1,660億4千1百万円の実施による減少、自己株式取得による減少114億7千8百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は71.7%となりました。

(3) 当四半期のキャッシュ・フローの概況

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ970億円減少し、4,084億1千3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資11億9千4百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ966億4千2百万円減少し、4,096億8百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ437億9千万円増加の1,187億4千5百万円の収入となりました。主として税金等調整前四半期純利益2,154億9千5百万円、前受金の増加235億6千4百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,001億8千4百万円、棚卸資産の増加362億6千9百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出343億4百万円により、前年同期の541億7千8百万円の支出に対し385億2千万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として配当金の支払1,660億4千1百万円により、前年同期の1,511億3千4百万円の支出に対し1,784億7千7百万円の支出となりました。

【四半期連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	74,955	118,745
税金等調整前四半期純利益	151,966	215,495
減価償却費	17,159	22,509
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)	94,146	△15,368
棚卸資産の増減額(△は増加)	△5,381	△36,269
仕入債務の増減額(△は減少)	△19,865	14,727
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△99,924	△100,184
その他	△63,145	17,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,178	△38,520
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△0	△336
有形固定資産の取得による支出	△51,018	△34,304
その他	△3,159	△3,879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△151,134	△178,477
自己株式の取得による支出	△0	△11,478
配当金の支払額	△150,254	△166,041
その他	△879	△957
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,565	1,251
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△128,790	△97,000
現金及び現金同等物の期首残高	485,072	505,414
現金及び現金同等物の四半期末残高	356,281	408,413
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間 が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	367,510	409,608

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

①連結業績予想の修正

情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを背景に、半導体の役割とその技術革新の重要性が高まるとともに、半導体製造装置市場も中長期的にはさらなる成長が見込まれております。

2027年3月期中間期の連結業績見通しにつきましては、最新の顧客設備投資動向を踏まえ、2026年4月30日に公表した連結業績予想を以下のとおり修正いたします。なお、2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震について、当社グループ事業所の建物・設備に大きな損害は確認されておらず、現時点において業績への影響は軽微であると判断しております。

また、通期連結業績予想につきましては、中間期の決算発表時に開示する予定です。

2027年3月期中間期の連結業績予想(2026年4月1日～2026年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 中間純利益	1株当たり 中間純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	1,570,000	431,000	437,000	328,000	721.12
今回修正予想(B)	1,620,000	458,000	464,000	349,000	767.51
増減額(B-A)	50,000	27,000	27,000	21,000	—
増減率(%)	3.2	6.3	6.2	6.4	—
(ご参考)前期実績 2026年3月期中間期	1,179,668	303,153	306,896	241,626	527.31

②配当予想の修正

当社の配当政策は、業績連動型配当を基本としており、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目標としております。

2027年3月期中間期の連結業績予想の修正に伴い、2026年4月30日に公表した2027年3月期の中間配当予想を1株当たり361円から384円に修正いたします。なお、2027年3月期の期末配当につきましては現時点では未定であり、中間期の決算発表時に通期連結業績予想と併せて開示する予定です。

	年間配当額		
	中間 (第2四半期末)	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想	361.00	—	—
今回修正予想	384.00	—	—
前期実績 (2026年3月期)	264.00	364.00	628.00

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	451,252	409,608
受取手形、売掛金及び契約資産	525,898	544,067
有価証券	54,998	—
商品及び製品	286,052	289,501
仕掛品	210,570	240,417
原材料及び貯蔵品	216,494	221,633
その他	90,389	98,056
貸倒引当金	△189	△264
流動資産合計	1,835,466	1,803,020
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	301,272	312,702
その他（純額）	288,062	297,664
有形固定資産合計	589,335	610,367
無形固定資産		
その他	37,531	38,720
無形固定資産合計	37,531	38,720
投資その他の資産		
投資有価証券	225,453	343,303
その他	174,575	161,349
貸倒引当金	△1,364	△1,356
投資その他の資産合計	398,664	503,296
固定資産合計	1,025,530	1,152,384
資産合計	2,860,997	2,955,405

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	127,844	143,902
未払法人税等	108,992	63,862
前受金	270,491	294,326
製品保証引当金	40,527	41,192
その他の引当金	39,557	27,055
その他	91,829	114,535
流動負債合計	679,242	684,874
固定負債		
その他の引当金	3,818	3,201
退職給付に係る負債	55,642	56,780
その他	52,297	67,647
固定負債合計	111,758	127,629
負債合計	791,001	812,503
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	2,083,371	1,986,059
自己株式	△420,660	△336,437
株主資本合計	1,795,683	1,782,594
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	147,962	228,581
繰延ヘッジ損益	△17	△3
為替換算調整勘定	86,546	92,280
退職給付に係る調整累計額	16,123	14,603
その他の包括利益累計額合計	250,614	335,461
新株予約権	23,697	24,845
純資産合計	2,069,996	2,142,901
負債純資産合計	2,860,997	2,955,405

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
売上高	549,586	732,388
売上原価	295,616	389,676
売上総利益	253,970	342,712
販売費及び一般管理費		
研究開発費	62,141	72,046
その他	47,134	59,257
販売費及び一般管理費合計	109,275	131,304
営業利益	144,694	211,407
営業外収益		
受取配当金	1,429	1,158
補助金収入	1,083	1,952
その他	1,919	1,836
営業外収益合計	4,432	4,947
営業外費用		
為替差損	1,683	504
その他	96	224
営業外費用合計	1,779	728
経常利益	147,347	215,626
特別利益		
固定資産売却益	24	15
付加価値税還付金	4,849	—
特別利益合計	4,873	15
特別損失		
固定資産除売却損	254	145
特別損失合計	254	145
税金等調整前四半期純利益	151,966	215,495
法人税等	34,165	51,153
四半期純利益	117,801	164,341
親会社株主に帰属する四半期純利益	117,801	164,341

四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
四半期純利益	117,801	164,341
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	45,860	80,612
為替換算調整勘定	5,408	5,696
退職給付に係る調整額	△1,065	△1,493
持分法適用会社に対する持分相当額	△213	31
その他の包括利益合計	49,990	84,846
四半期包括利益	167,791	249,188
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	167,791	249,188

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2026年3月27日開催の取締役会決議に基づき、2026年4月30日付で自己株式の消却を行いました。これにより利益剰余金及び自己株式は、当第1四半期連結累計期間において95,470百万円それぞれ減少しております。

また、当社は2026年5月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式は、当第1四半期連結累計期間において11,478百万円増加しております。

これらの結果等により、当第1四半期連結会計期間末において利益剰余金は1,986,059百万円、自己株式は336,437百万円となりました。

(当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
減価償却費	17,159百万円	22,509百万円
のれんの償却額	99百万円	88百万円

(セグメント情報等の注記)

当社グループは、「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。